19 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭63-32764

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)3月2日

B 24 D 15/04 11/00

Z-6826-3C A-6826-3C

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

ワイピング材

②実 顧 昭61-123423

愛出 願 昭61(1986)8月13日

砂考 案 者

田中範

東京都中野区弥生町5丁目9番3号 東洋リントフリー株

式会社内

砂考 案 者 井 口

弘高

東京都中野区弥生町5丁目9番3号 東洋リントフリー株

式会社内

⑪出 願 人 東

東洋リントフリー株式

東京都中野区弥生町5丁目9番3号

会社

邳代 理 人 弁理士 武田 賢市



明 細 書

- 1.考案の名称
 ワイピング材
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - (1) 高密度微細構造を有する加工布を使用して袋 状本体を形成し、この袋状本体の内部に合成繊 維製不織布からなる芯材を配置し、さらに前記 袋状本体の所定個所を縫着して芯材を固定する ことを特徴とするワイピング材。

る実用新案登録請求の範囲第1項記載のワイピング材。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この考案は、拭い材(以下ワイピング材という)に関するものであり、一層詳細には、乗用車等の生産ラインにおける塗装工程での微小な付着物などを払拭する際に好適に使用されるワイピング材に関するものである。

(従来技術およびその問題点)

一般に、自動車車体の塗装は焼付塗装が行われており、乗用車のようにその価値水準の高いものは下塗り、中塗りおよび上塗りの三回塗り仕上げあるいは四回塗り仕上げなどが採用されている。

ところで、前述の三回塗り塗装工程の場合、例えば、中塗りの焼付乾燥後にサンドペーパー、回転サンダあるいはバイブレーションサンダなどで塗面を研磨した後、ミクロン単位の微小な付着物を払拭して塗装面を平滑にすると共に上塗り塗膜との密着性を向上させる、所謂、研ぎ作業が行わ



れている。

しかるにこのようなミクロン単位の微小な付着物を払拭する手段として、タオル地等からなるワイピング材を湿らせて制電性を付与したものを使用しているが、この種のワイピング材は払拭後にワイピング材自体の繊維くずなどが付着あるいは残留して次段工程に不都合を生ずるという問題点を有していた。

〔問題点の解決手段〕

そこで、この考案では、前述の問題点を解決するために、ワイピング材を高密度微細構造を有する加工布を使用して形成した袋状本体の内部に合成繊維製不織布からなる芯材を配置し、この袋状本体の所定個所を縫着して芯材を固定することにより構成して、ミクロン単位の微小な付着物を可及的に払拭し得るようにしたものである。

〔作用〕

この考案に係るワイピング材では、塗装面にお けるミクロン単位の微小な付着物は、湿らせたワ イピング材の高密度微細構造を有する加工布で確



実に捕らえられ拭き取られる。

〔実施例〕

次に、本考案に係るワイピング材の好適な実施 例につき添付図面を参照しながら以下詳細に説明 する。

第1図において、本考案に係るワイピング材は、 高密度微細構造を有する加工布10を使用して袋 状本体12を形成し、この袋状本体12の内部に 不織布からなる芯材14を配置し、さらに前記袋 状本体12を芯材14と共に縫着して芯材14を 固定することにより構成されている。

神

なお、本実施例において、芯材14は、本体1 2 を矩形状に四つ折めして使用する場合の使い勝 手を想定して縫着固定されているが、袋状本体1 2 内で芯材14が移動しなければ、例えば、第3 図に示すように対角線上を縫着する等適宜の固定 方法を採用できることは勿論である。



〔 効 果 〕

先に述べたように、本考案に係るワイピング材は、柔軟で芯材の保水性も高く、しかも制電に 物で塗面上のミクロン単位の付着 袋を ないることができるだけでなるためで まますることができるだけで ないまないのではよりも摩擦強を はないので耐久性に富み、洗浄あるいは ない返し使用が可能である等種々の利点を有して 実用的効果は極めて大きい。



以上、本考案に係るワイピング材の好適な実施 例につき説明したが、本考案はこの実施例に限定 されるものではなく、例えば、使用に便宜なよう に適宜の形状にしたり、あるいは矩形状布体と略 同一形状に設定した芯材を使用して袋状本体内に 重畳した芯材を固定することにより保水性を向上 させる等、本考案の精神を逸脱しない範囲内にお いて種々の改変をなし得ることは勿論である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係るワイピング材の好適な実 施例を示す一部切欠断面斜視図、第2図は第1図 に示すワイピング材を製造する場合の手順を示す 説明図、第3図は本考案に係るワイピング材の別 の実施例を示す斜視図である。

10……加工布

12……袋状本体

1 4 ……芯材

16……矩形状布体

18……開放側緣部 20……縫着線

実用新案登録出願人 東洋リントフリー株式会社 H 蜸 弁 理 士 武 代 理 人

公開 吳用 昭和63- 32764

